

(43) 国際公開日
2008年3月20日 (20.03.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/032738 A1

- (51) 国際特許分類:
C22C 9/06 (2006.01) C22F 1/00 (2006.01)
C22F 1/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/067730
- (22) 国際出願日: 2007年9月12日 (12.09.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-246961 2006年9月12日 (12.09.2006) JP
特願2007-236003 2007年9月11日 (11.09.2007) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 古河電気工業株式会社 (THE FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 三原 邦照 (MIHARA, Kuniteru) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区

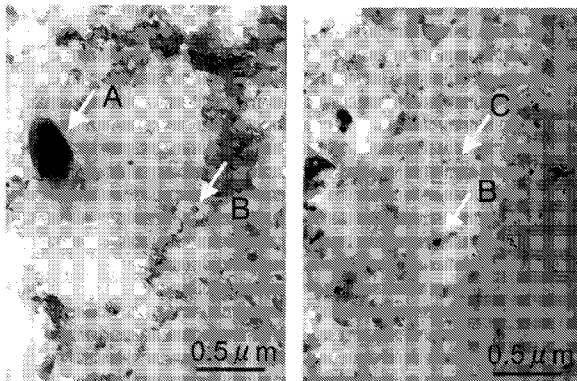
丸の内2丁目2番3号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 江口 立彦 (EGUCHI, Tatsuhiko) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 飯田 敏三 (IIDA, Toshizo); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

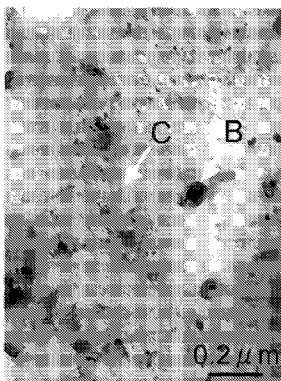
(54) Title: COPPER ALLOY PLATE MATERIAL FOR ELECTRICAL/ELECTRONIC EQUIPMENT AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 電気・電子機器用銅合金板材およびその製造方法



(a)

(b)



(c)

(57) Abstract: A copper alloy plate material for electrical/electronic equipment consisting of a copper alloy comprising 2.0 to 5.0 mass% Ni, 0.43 to 1.5 mass% Si and the balance Cu and unavoidable impurities, wherein there are contained three types of intermetallic compounds containing Ni and Si in a total amount of 50 mass% or more (A, B, C), and wherein the intermetallic compound A has a compound diameter of 0.3 to 2 μm , the intermetallic compound B a compound diameter of 0.05 to less than 0.3 μm and the intermetallic compound C a compound diameter of more than 0.001 to less than 0.05 μm .

(57) 要約: Niを2.0~5.0mass%、Siを0.43~1.5mass%含有し、残部がCuと不可避不純物からなる銅合金で形成される銅合金板材であって、NiとSiを合計で50mass%以上含む3種類の金属間化合物A、B、Cを含有し、前記金属間化合物Aの化合物径は0.3 μm 以上2 μm 以下であり、前記金属間化合物Bの化合物径は0.05 μm 以上0.3 μm 未満であり、前記金属間化合物Cの化合物径は0.001 μm を越え0.05 μm 未満である電気・電子機器用銅合金板材。



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書